

沈阳富创精密设备股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的 半年度评估报告

沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为本”的发展理念，维护公司全体股东利益，基于对未来发展前景的信心，于 2026 年 4 月制定了《2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案》（以下简称“行动方案”）。自 2026 年行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作并以此为基础，持续推动优化经营、规范治理和回报投资者。

2026 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司<2026 年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告>的议案》，根据上半年公司对行动方案的执行情况，公司董事会拟定了行动方案的半年度评估报告，具体如下：

一、 专注公司主营业务，提升核心竞争力

根据 SEMI 发布的《年中总半导体设备市场预测报告（Mid-Year Total Semiconductor Equipment Forecast - OEM Perspective）》对行业走势作出明确预判：2026 年全球半导体制造设备（OEM）总销售额将突破历史峰值，达到 1,659 亿美元，同比增长 23.2%。行业增长红利具备长期性，整体增长势头将持续延续至 2028 年，总设备销售额有望达到创纪录的 2,295 亿美元，实现连续五年增长，AI 催生的全新市场需求，正深度重构全球半导体制造的投资逻辑与产业格局，成为行业长期增长的核心驱动力。

伴随国内半导体设备国产化率持续提升以及下游晶圆厂持续扩产，行业整体需求快速释放、头部设备厂商订单规模显著增长，有效带动公司整体业务实现高速增长。报告期内，公司各生产基地产能逐步释放，规模生产带来单位制造成本优化，经营业绩实现改善，凭借超高的产品配套覆盖率、先进制程的优势产品及大客户服务战略，进一步稳固了国内半导体设备精密零部件领军企业的行业地位。

公司持续推进平台化发展战略，着力开展核心技术迭代优化、产品矩阵完善及客户服务体系升级工作。作为长期服务国内外头部半导体设备厂商的精密零部

件企业，公司坚持以自主创新为核心驱动力，不断推进核心技术升级与产品系列迭代，持续夯实研发创新与数智化建设能力。报告期内，公司获评“辽宁省智改数转标杆企业”，通过技术能力的持续提升，把握行业发展机遇。

在国家重大专项方面，公司与客户联合承担的 2 项国家专项顺利通过验收，相关产品经先进制程验证实现批量供货，在客户面临断供风险时有效保障产线稳定运行，筑牢国家集成电路产业供应链安全根基。南通富创亦成功获批首批国家专项，进一步提升公司智能制造与数字化发展水平。

报告期内，公司依托平台化与智能化的协同布局，系统提升对全球半导体设备龙头企业的综合服务能力。通过技术升级与产品创新，市场竞争力持续增强，业务规模持续扩张，2025 年度实现营业收入 35.43 亿元，同比增长 16.58%。报告期内，核心客户合作黏性持续增强，公司前五大客户营收占比合计达 70%以上。

在业务拓展方面，气体传输系统作为公司重点培育的第二增长曲线，实现了较为明显的增长态势。2025 年度，该板块实现营业收入 11.06 亿元，较上年同期增长超过 25%，市场份额稳居国内领先地位，展现出强劲的发展动能与市场竞争优势。

2026 年，公司将以大平台为基地，推动标准化体系、技术规范与生产流程的全球一体化，实现境内外研发、制造与服务的高效衔接，为半导体设备关键零部件本土化供应提供坚实支撑。对内持续巩固技术研发与精益管理能力，对外深化全球客户协作与产业链资源整合，一方面强化国内半导体设备厂商配套服务能力，另一方面积极拓展海外高端市场；在巩固传统精密零部件业务优势的基础上，以五大产品专项为抓手培育新增长极，通过战略投资、并购重组强化上下游协同，提升关键工艺与产品自主化水平，助力半导体产业链自主可控。同时，公司将同步推进品牌矩阵构建，以极致的产品质量筑牢品牌根基——秉持“零缺陷”的品质标准，打造高认可度的产业品牌，实现品牌价值与产业竞争力的双重提升。

二、 加快发展新质生产力，创新配置生产要素

中国作为全球半导体产业链的重要市场，报告期内持续带动本土设备产业创新升级，国内设备企业加快核心技术攻关与国产化替代。公司作为半导体设备精密零部件领域的领军企业，围绕技术创新与产品迭代实现多项关键突破：

在技术研发方面，公司多项核心技术实现重要突破：一是表面处理领域“N 系列膜层”完成近千万级订单的生产与交付；二是建成国内领先的镀金工艺技术能力，可满足行业最高性能标准，已承接国内头部客户国产化替代的千万级新增订单；三是气体传输系统集成技术取得重大进展，气柜 S6 仿真技术可完整复现 SEMI S6 全部测试边界，处于行业领先水平。

在匀气盘先进产品领域，公司聚焦先进制程零部件国产化需求，顺利完成多款高度集成化新型匀气盘产品研发落地，产品广泛适配先进逻辑、先进存储产线的刻蚀、薄膜沉积等核心化学反应工序。公司重点研发的多层钎焊内腔匀气盘，集成小孔遮蔽、多层钎焊、高洁净清洗、内腔阳极氧化等多项复杂精密工艺，实现全流程自主可控生产，保障表面处理量产稳定性，成功突破行业高端匀气盘制造瓶颈。同时，公司研发的高深宽比同心槽匀气盘可精准适配 Harp 先进工艺，为半导体先进制程薄膜沉积环节提供可靠的核心零部件支撑。此外，内腔喷砂匀气盘、超长进气流道焊接加热匀气盘等新品的开发落地，进一步丰富了公司高端匀气盘产品矩阵，夯实了公司在高端半导体精密零部件领域的市场地位，持续助力半导体设备核心零部件国产化进程。

在金属加热盘领域，公司产品通过多家国内外头部设备厂商认证、实现国产化替代并成为核心供应商，其中铝合金加热盘实现多款量产及多型号小批量供货，不锈钢加热盘攻克焊接工艺与高温均性技术难点，实现多型号规模化生产，产品应用于 PECVD、Strip ETCH 等核心机台。

静电卡盘方面，公司成功突破海外技术壁垒，相关产品完成国内部分设备厂商验证并实现国产化替代，跻身核心供应商行列，铝基与陶瓷板粘接类、浆料印刷类静电卡盘达成首件技术突破，产品可适配 ETCH、CVD、PVD、IMP、CD-SEM 等核心机台。

除此外，公司在表面处理特种工艺领域构建了差异化技术优势，在耐蚀涂层方面，自主研发的“致密 YO 涂层”持续在国内头部客户多类设备机型上开展工艺验证，凭借过硬的技术能力实现供货规模稳步拓展。在新一代技术迭代上，公司研发的超高“致密 YO 涂层”优势显著，目前已在国内多家头部客户新型设备上开展常态化验证，工艺表现稳定、应用效果良好。此外，公司“PS 类 SHD 产品”

已顺利完成国内头部客户批量工艺验证，业务现已进入持续放量阶段，产品性能可充分匹配先进制程严苛要求，形成显著的差异化市场竞争优势。

在纳米薄膜技术方面，公司开发的“N 系列膜层、O 系列膜层”产品均已实现规模化量产与稳定交付。其中，“N 系列膜层”在报告期内近千万级订单完成生产并交付，技术优势持续转化为市场增量。同时，公司持续深耕技术研发，相继推出“YO 系列新型膜层”和“Y-Al-O 系列新型膜层”产品，其中“YO 系列新型膜层”已通过国内头部客户工艺验证，正式进入批量供应阶段。

随着先进制程对耐高温、粒子控制及金属污染抑制要求的指数级提升，公司表面处理技术的性能壁垒将进一步增厚，为国产半导体设备突破更先进逻辑芯片制造瓶颈提供底层工艺支撑。

公司将持续加大研发投入，重点突破 7 纳米及 5 纳米先进制程设备零部件的核心技术，拓展高附加值产品品类，重点发力加热盘、阀门产品的市场落地与产能释放；静电卡盘专项制定 3-5 年长期发展规划，稳步推进技术突破、客户验证与产业化落地。同时将持续加大在原材料机理、等离子反应原理、新型表面处理技术、贴近应用场景的实验和检测平台搭建等方面的研发投入，为中国半导体生态全面向先进制程迈进贡献力量。

三、 积极保障投资者权益，统筹规划业绩与回报的动态平衡

公司高度重视股东的投资回报，努力践行长期、健康、可持续的股东价值回报机制。报告期内，公司结合现阶段经营业绩情况、未来资金投入需求和公司可持续发展需要，同时兼顾全体股东的长远利益等因素，于 2026 年 4 月 17 日、4 月 28 日分别召开第二届董事会审计委员会第十七次会议、第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》和《关于授权董事会进行 2026 年度中期分红的议案》，并同意将上述议案提交公司 2025 年年度股东会审议。2026 年 6 月 1 日，公司召开 2025 年年度股东会，审议通过了上述事项，同意授权董事会制定并实施中期分红事宜。

截至本报告披露日，公司于 2026 年 8 月 21 日、2026 年 8 月 27 日分别召开第二届董事会审计委员会第十九次会议、第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司 2026 年半年度利润分配方案的议案》，拟以权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数分配利润，向全体股东

每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元(含税), 拟合计派发现金红利 60,980,713 元(含税)。

公司仍将结合业务现状以及未来发展规划, 统筹规划公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡, 在符合相关法律法规及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》利润分配政策的前提下, 维持并努力提升股东回报水平, 落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制。

四、 完善与投资者沟通机制, 夯实资本市场发展基础

报告期内, 公司积极接听投资者专线、回复“上证 E 互动”平台提问, 在“上证路演中心”、“进门财经”平台举办业绩说明会。

除业绩说明会外, 公司通过线上及线下方式接待投资者交流, 持续与资本市场沟通公司经营管理状况、产品技术、产能建设等相关信息, 充分保护投资者合法权益。

报告期内, 公司持续参与国际专业展会, 加大数字化营销、内容营销与全球化品牌传播投入, 全面提升公司品牌在全球半导体领域的知名度, 打通渠道资源、客户资源、产品资源共享机制, 实现全球销售体系高效联动。公司将继续关注股东诉求、重视资本市场, 严格遵循法律法规及监管要求, 依照公司《投资者关系管理办法》积极展开投资者交流活动并及时履行信息披露义务。

五、 持续完善公司治理, 提升规范运作水平

在三会运作方面, 公司在报告期内共召开股东会 2 次, 董事会 4 次, 发挥了董事会、各专门委员会、独立董事的各项职能。

未来, 公司仍将践行“以投资者为本”的上市公司发展理念, 切实维护全体股东利益, 履行上市公司责任, 进一步推动公司高质量发展, 共同促进资本市场平稳健康发展。

六、 进一步改进措施

未来, 公司将持续评估行动方案的执行情况, 及时履行信息披露义务, 并将继续专注主业, 通过良好的盈利能力、经营质量和积极的投资者回报, 切实保护投资者利益, 回报投资者信任, 维护公司良好市场形象, 促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

特此报告。

沈阳富创精密设备股份有限公司

2026 年 8 月 31 日